2-2822979-4 ! 即将停产

TE 内部编号 2-2822979-4

TE 内部产品描述 LGA3647-1 SOCKET-P1 KIT FOR ODM (30U AU)

LGA 3647 Sockets

在 TE 官网查看>

连接器 > 接口插槽 > IC 插座 > LGA 插座 > LGA 3647 Sockets

IC 插座类型: **LGA 3647**

位数: **3647**

端子接合区域电镀材料厚度: **[30 µin]**

中心线（间距）: **.86 mm, .99 mm [.034 in, .039 in]**

PCB 端接方法: **表面贴装 - 焊球**

所有 LGA 3647 Sockets (0)

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	3647
栅格间距	.9906 x .8585 mm[.039 x .0338 in]

主体特性

框架种类	正方形

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子基材	铜合金
IC 插座类型	LGA 3647
	30 µin
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装 - 焊球

机械附件

连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	高温热塑塑料
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	.86 mm, .99 mm[.034 in][.039 in]

使用环境

工作温度范围	-25 – 100 °C[-13 – 212 °F]

操作/应用

电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 2821719-1
IFP/LEC CBL ASSY 2 PORT TYPE A STR

TE 产品编号 2821719-2
IFP/LEC CBL ASSY 2 PORT TYPE A STR

TE 产品编号 2821719-3
IFP/LEC CBL ASSY 2 PORT TYPE A STR

TE 产品编号 2821719-4
IFP/LEC CBL ASSY 2 PORT TYPE A STR

TE 产品编号 2821720-1
IFP/LEC CBL ASSY 2 PORT TYPE A STR INV

TE 产品编号 2821720-2
IFP/LEC CBL ASSY 2 PORT TYPE A STR INV

客户还购买了

TE 产品编号640250-8
Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156

TE 产品编号641550-1
SL156 RECPT PTPBR

TE 产品编号2-2822979-3
LGA3647-0 SOCKET P0 KIT FOR ODM (30U AU)

文档

产品图纸

LGA3647-1 SOCKET-P1 KIT FOR ODM (30U AU)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2822979-4_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2822979-4_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2822979-4_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

LGA 3647 Socket Product Flyer

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本